



Fig. 2. 사용된 열전소자의 샘플 사진 (해결 전, 후)

3. 결론

열전소자의 도금기로서의 치환형 무전해 금도금기술을 제안하였다. 본 치환형 도금기술 연구를 통하여 Cu 이외의 세라믹 기판에는 Au가 도금되지 않았다. 기존의 도금에서는 솔더링 후 일부 부풀음(blister)이 발생하였다. 하지만 본 치환형 도금기술을 적용함으로써 부풀음이 발생하지 않았고 플럭스 처리 후에도 세라믹 기판에 솔더는 석출되지 않았다.

참고문헌

1. Saniya LeBlanc, Sustainable Materials and Technologies, 8권(2014) 26.
2. 한국산업기술협회, PCB핸드북, (2004) 258.
3. 한국산업기술협회, 도금표면처리 현장실무, 2권26호(2007) 229.